



出願人/権利者	件数
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD	1358
APPLIED MATERIALS INC	689
COUPANG CORP	673
QUALCOMM INCORPORATED	552
TOKYO ELECTRON LTD	514
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	483
AUO CORP	420
NANYA TECH CORPORATION	372
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD	342
INDUSTRIAL TECH RESEARCH INSTITUTE	335
NITTO DENKO CORP	334
SCREEN HOLDINGS CO LTD	332
DELTA ELECTRONICS INC	326
ACER INCORPORATED	323
INVENTEC CORP	307
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	284
CHINA STEEL CORP	262
KIOXIA CORP	258
DISCO CORP	239
SHIN ETSU CHEMICAL CO LTD	220
WONDERLAND SWITZERLAND AG	214
LAM RES CORPORATION	209
APPLE INC	201
FUJIFILM CORP	196
RESONAC CORP	191
ASML NETHERLANDS B V	180
UNITED MICROELECTRONICS CORP	176
COMPAL ELECTRONICS INC	170
LG DISPLAY CO LTD	170
SEMICONDUCTOR ENERGY LABORATORY CO LTD	169
INTEL CORP	168
BANK OF TAIWAN	167
MEDIATEK INC	161
ASUSTEK COMPUTER INC	159
TAIWAN COOPERATIVE BANK CO LTD	156
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	148
WINBOND ELECTRONICS CORP	147



出願人/権利者	件数
KLA CORP	146
TAIPEI CITY UNIV OF SCIENCE AND TECHNOLOGY	144
FORD GLOBAL TECH LLC	137
SHIMANO INC	137
MOLEX LLC	136
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD	136
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS CO LTD	135
NAN YA PLASTICS CORP	131
LG CHEM LTD	130
LINTEC CORP	128
MACRONIX INTERNATIONAL CO LTD	128
ENTEGRIS INC	126
NUVOTON TECH CORPORATION	126



IPC	技術内容	件数
H01L	クラスH10に包含されない半導体装置	8185
G06F	電氣的デジタルデータ処理	4891
G06Q	管理目的, 商用目的, 金融目的, 経営目的または監督目的に特に適合した情報通信技術 [ICT]; 他に分類されない, 管理目的, 商用目的, 金融目的, 経営目的または監督目的に特に適合したシステムまたは方法	2756
H05K	印刷回路; 電氣装置の箱体または構造的細部, 電氣部品の組立体の製造	2687
G02B	光学要素, 光学系, または光学装置	2281
A61K	医療用製剤, 歯科用製剤又は化粧用製剤	2147
A61P	化合物または医薬製剤の特殊な治療活性	1711
H10D	無機電氣的半導体装置	1554
B32B	積層体, すなわち平らなまたは平らでない形状, 例, 細胞状またはハニカム状, の層から組立てられた製品	1458
G03F	フォトメカニカル法による凹凸化又はパターン化された表面の製造, 例, 印刷用, 半導体装置の製造法用; そのための材料; そのための原稿; そのために特に適合した装置	1390
G02F	本サブクラスに包含される素子の媒体の光学的性質の変化により光を制御するための光学装置または光学的配置; 光の周波数変更; 光学的理論素子; 光学的アナログ/デジタル変換器	1215
C08L	高分子化合物の組成物	1212
G01N	材料の化学的または物理的性質の決定による材料の調査または分析	1178
H01R	導電接続; 互いに絶縁された多数の電氣接続要素の構造的な集合体; 嵌合装置; 集電装置	1138
C23C	金属質への被覆; 金属材料による材料への被覆; 表面への拡散, 化学的変換または置換による, 金属材料の表面処理; 真空蒸着, スパッタリング, イオン注入法または化学蒸着による被覆一般	1112
H04N	画像通信, 例, テレビジョン	1024
C09K	他に分類されない応用される物質; 他に分類されない物質の応用	975
C08G	炭素-炭素不飽和結合のみが関与する反応以外の反応によって得られる高分子化合物	973
G01R	電氣的変量の測定; 磁氣的変量の測定	945
G11C	静的記憶	938
C08J	仕上げ; 一般的混合方法; サブクラスC08B, C08C, C08F, C08GまたはC08Hに包含されない後処理	935



IPC	技術内容	件数
B65D	物品または材料の貯蔵または輸送用の容器, 例. 袋, 樽, びん, 箱, 缶, カートン, クレート, ドラム缶, 広口びん, タンク, ホッパー, 運送コンテナ; 付属品, 閉鎖具, または閉鎖具のための付属品; 包装要素; 包装体	900
C08K	無機または非高分子有機物質の添加剤としての使用	896
H04L	デジタル情報の伝送, 例. 電信通信	887
H04W	無線通信ネットワーク	879
H10B	電子記憶装置	838
H01J	電子管または放電ランプ	829
A61B	診断; 手術; 個人識別	812
C08F	炭素-炭素不飽和結合のみが関与する反応によってえられる高分子化合物	783
C07D	複素環式化合物	778
G06T	イメージデータ処理または発生一般	743
C09J	接着剤; 接着方法一般の非機械的観点; 他に分類されない接着方法; 物質の接着剤としての使用	728
G06N	特定の計算モデルに基づく計算装置	715
G09G	静的手段を用いて可変情報を表示する表示装置の制御のための装置または回路	686
B01D	分離	665
H10H	電位障壁を有する, 無機発光半導体装置	640
C09D	コーティング組成物, 例. ペンキ, ワニスまたはラッカー; パテ; 塗料除去剤インキ消し; インキ; 修正液; 木材用ステイン; 糊状または固形の着色料または捺染料; これらの物質の使用法	638
B29C	プラスチックの成形または接合; 他に分類されない可塑状態の材料の成形; 成形品の後処理, 例. 補修	630
H01M	化学的エネルギーを電気的エネルギーに直接変換するための方法または手段, 例. 電池	630
H10K	有機電氣的固体装置	616
C07K	ペプチド	595
B65G	運搬または貯蔵装置, 例. 荷積みまたは荷あげ用コンベヤ; 作業場コンベヤシステムまたは気体式チューブコンベヤ	579
B23K	ハンダ付またはハンダ離脱; 溶接; ハンダ付または溶接によるクラッドまたは被せ金; 局部加熱による切断, 例. 火炎切断; レーザービームによる加工	531



IPC	技術内容	件数
H02M	交流－交流，交流－直流または直流－直流変換装置，および主要な，または類似の電力供給システムと共に使用するための装置：直流または交流入力－サージ出力変換；そのための制御または調整	530
H10F	赤外線，可視光，短波長電磁波または粒子線の輻射に感応する無機半導体装置	527
C12N	微生物または酵素；その組成物；微生物の増殖，保存，維持；突然変異または遺伝子工学；培地	510
B24B	研削または研磨するための機械，装置，または方法	506
G06V	イメージまたはビデオの認識または理解	506
H04B	伝送	499
C07C	非環式化合物または炭素環式化合物	498